

2014-2020年中国挠性覆铜 板（FCCL）市场竞争力分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2020年中国挠性覆铜板（FCCL）市场竞争力分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1409/T12853SYP0.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-09-17

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2020年中国挠性覆铜板（FCCL）市场竞争力分析及投资前景研究报告》共十二章，报告对我国挠性覆铜板（FCCL）的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

FCCL除具有薄、轻和可挠性的优点外，用聚酰亚胺基膜的FCCL，还具有电性能、热性能、耐热性优良的特点。它的较低介电常数（Dk）性，使得电信号得到快速的传输。良好的热性能，可使得组件易于降温。较高的玻璃化温度（Tg）可使得组件在更高的温度下良好运行。由于FCCL大部分的产品，是以连续成卷形态提供给用户，因此，采用FCCL生产印制电路板，利于实现FPC的自动化连续生产和在FPC上进行元器件的连续性的表面安装。

第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求 1

第一节 按不同基材分类的FCCL品种 1

第二节 按不同构成分类的FCCL品种 1

第三节 按不同应用领域分类的FCCL品种 1

第四节 FCCL品种的其他分类 2

第五节 产品主要采用的标准及性能要求 2

一、FCCL相关标准 2

二、FCCL的主要性能要求 3

第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究 5

第一节 三层型FCCL的制造工艺法及其特点 5

一、片状制造法 5

二、卷状制造法 6

第二节 二层型FCCL的制造工艺法及其特点 7

一、涂布法 7

二、溅射/电镀法 7

三、层压法 8

四、三种工艺法生产的2L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较 8

第三节 近年FPC的技术发展方面 9

一、二层型FCCL已成品种发展的主流 9

二、FCCL近年在技术方面的进步 9

第三章 2012-2013年世界挠性覆铜板市场发展现状分析 12

第一节 2012-2013年世界挠性覆铜板产业发展概述 12

一、挠性覆铜板发展历程 12

二、世界FCCL市场规模及两品种的比例 14

三、世界挠性覆铜板市场的规模 18

第二节 2012-2013年世界挠性覆铜板区域市场分析 19

一、美国 19

二、日本 20

三、德国 21

四、韩国 21

第三节 2013-2020年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析 22

第四章 2012-2013年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析 23

第一节 新日铁化学株式会社 23

一、公司基本概况 23

二、2012-2013年公司经营与销售情况分析 24

三、2012-2013年公司竞争优势分析 24

四、公司国际化战略发展 24

第二节 宇部兴产株式会社 25

一、公司基本概况 25

二、2012-2013年公司经营与销售情况分析 26

三、2012-2013年公司竞争优势分析 26

四、公司国际化战略发展 26

第三节 单位台湾律胜科技股份有限公司 28

一、公司基本概况 28

二、2012-2013年公司经营与销售情况分析 29

三、2012-2013年公司竞争优势分析 29

四、公司国际化战略发展 30

第四节 新揚科技股份有限公司 30

一、公司基本情况	30
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析	30
三、2012-2013年公司竞争优势分析	30
四、公司国际化战略发展	31
第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司	31
一、公司基本情况	31
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析	31
三、2012-2013年公司竞争优势分析	34
四、公司国际化战略发展	34
第六节 旗胜科技股份有限公司	34
一、公司基本情况	34
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析	35
三、2012-2013年公司竞争优势分析	35
四、公司国际化战略发展	36
第七节 东丽世韩有限公司	36
一、公司基本情况	36
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析	36
三、2012-2013年公司竞争优势分析	37
四、公司国际化战略发展	37
第八节 SD电线有限公司	37
一、公司基本情况	37
二、2012-2013年公司经营与销售情况分析	38
三、2012-2013年公司竞争优势分析	38
四、公司国际化战略发展	39
第五章 2012-2013年中国挠性覆铜板产业运营态势分析	40
第一节 2012-2013年中国挠性覆铜板产业发概况	40
一、国内挠性覆铜板产品结构分析	40
二、中国挠性覆铜板应用情况分析	40
三、中国挠性覆铜板生产情况分析	41
第二节 2012-2013年中国挠性覆铜板市场运行现状分析	41
一、挠性覆铜板需求格局分析	41

二、中国挠性覆铜板市场发展机遇分析	43
三、挠性覆铜板市场最新动态分析	44
第三节 2012-2013年中国挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析	52
第六章 2012-2013年中国挠性覆铜板相关行业发展形势分析	54
第一节 2012-2013年中国挠性印制电路业发展分析	54
一、我国FPC生产现状	54
二、我国FPC生产企业的现状	55
三、我国FPC业技术的现状	56
第二节 二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展	58
一、驱动IC用COF	58
二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展	58
三、我国COF挠性基板生产现状	60
第七章 2010-2012年国内挠性覆铜板行业（所属行业）数据监测分析	64
第一节 2010-2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）总体数据分析	64
一、2010年中国挠性覆铜板行业全部企业（所属行业）数据分析	64
二、2011年中国挠性覆铜板行业全部企业（所属行业）数据分析	66
三、2012年中国挠性覆铜板行业全部企业（所属行业）数据分析	67
第二节 2010-2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析	69
一、2010年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析	69
二、2011年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析	70
三、2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同规模企业数据分析	70
第三节 2010-2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析	71
一、2010年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析	71
二、2011年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析	71
三、2012年中国挠性覆铜板行业（所属行业）不同所有制企业数据分析	72
第八章 2012-2013年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析	73
第一节 金安国纪科技股份有限公司（002636）	73
一、企业概况	73
二、企业主要经济指标分析	74
三、企业盈利能力分析	77

四、企业偿债能力分析	77
五、企业运营能力分析	78
六、企业成长能力分析	78
第二节 广东生益科技股份有限公司 (600183)	79
一、企业概况	79
二、企业主要经济指标分析	80
三、企业盈利能力分析	82
四、企业偿债能力分析	83
五、企业运营能力分析	84
六、企业成长能力分析	84
第三节 依顿 (广东) 电子科技有限公司	85
一、企业概况	85
二、企业主要经济指标分析	85
三、企业盈利能力分析	86
四、企业偿债能力分析	86
五、企业运营能力分析	87
六、企业成长能力分析	87
第四节 山东金宝电子股份有限公司	88
一、企业概况	88
二、企业主要经济指标分析	89
三、企业盈利能力分析	90
四、企业偿债能力分析	90
五、企业运营能力分析	90
六、企业成长能力分析	91
第五节 广州美嘉伟华电子材料有限公司	91
一、企业概况	91
二、企业主要经济指标分析	91
三、企业盈利能力分析	92
四、企业偿债能力分析	92
五、企业运营能力分析	93
六、企业成长能力分析	93
第六节 江门建滔积层板有限公司	93

- 一、企业概况 93
- 二、企业主要经济指标分析 94
- 三、企业盈利能力分析 94
- 四、企业偿债能力分析 95
- 五、企业运营能力分析 95
- 六、企业成长能力分析 95
- 第七节 苏州松下电工有限公司 96
 - 一、企业概况 96
 - 二、企业主要经济指标分析 96
 - 三、企业盈利能力分析 97
 - 四、企业偿债能力分析 97
 - 五、企业运营能力分析 98
 - 六、企业成长能力分析 98
- 第八节 依顿（中山）多层线路板有限公司 98
 - 一、企业概况 98
 - 二、企业主要经济指标分析 98
 - 三、企业盈利能力分析 99
 - 四、企业偿债能力分析 99
 - 五、企业运营能力分析 100
 - 六、企业成长能力分析 100
- 第九节 国际层压板材有限公司 101
 - 一、企业概况 101
 - 二、企业主要经济指标分析 101
 - 三、企业盈利能力分析 102
 - 四、企业偿债能力分析 102
 - 五、企业运营能力分析 103
 - 六、企业成长能力分析 103
- 第十节 昆山大唐铜面基板有限公司 103
 - 一、企业概况 103
 - 二、企业主要经济指标分析 103
 - 三、企业盈利能力分析 104
 - 四、企业偿债能力分析 105

五、企业运营能力分析 105

六、企业成长能力分析 105

第九章 2012-2013年中国印刷电路板行业市场运行现状分析 106

第一节 2012-2013年中国印刷电路板行业的总体概况 106

一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度 106

二、我国将成为世界最大产业基地 106

三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群 108

四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低 108

五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态 109

第二节 2012-2013年我国印刷电路板市场发展现状分析 109

一、印刷电路板市场生产结构分析 109

二、印刷电路板市场需求特点分析 110

三、印刷电路板市场技术发展分析 111

第三节 2012-2013年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析 112

一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱 112

二、应对专利和新环保政策 113

三、内地本土所贡献的产出值比例很小 114

第四节 2012-2013年中国印刷电路行业发展对策分析 115

第十章 2012-2013年中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析 117

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜 117

一、绝缘基膜的生产方式 117

二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求 118

三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展 118

第二节 挠性覆铜板用导电材料 119

一、各类铜箔的品种及特征 119

二、压延铜箔 120

三、电解铜箔 121

四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求 125

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂 126

一、FPC用胶粘剂发展概述 126

- 二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况 130
- 三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况 131
- 四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况 135
- 五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种 139
- 第四节 挠性覆铜板用覆盖膜 140

第十一章 2013-2020年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析 142

第一节 2013-2020年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析 142

- 一、2013-2020年中国挠性覆铜板行业发展走向分析 142
- 二、对未来FPC技术发展的预测 142
- 三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求 143

第二节 2013-2020年中国挠性覆铜板行业市场预测分析 144

- 一、挠性覆铜板供给预测 144
- 二、挠性覆铜板市场需求预测 144
- 三、挠性覆铜板产品价格走势预测 145

第三节 2013-2020年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测 146

第十二章 2013-2020年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析 147

第一节 2013-2020年中国挠性覆铜板行业投资环境分析 147

第二节 2013-2020年挠性覆铜板行业投资机会分析 147

- 一、规模的发展及投资需求分析 147
- 二、总体经济效益判断 148
- 三、与产业政策调整相关的投资机会分析 148

第三节 2013-2020年中国挠性覆铜板行业投资风险分析 149

- 一、市场竞争风险 149
- 二、原材料压力风险分析 150
- 三、技术风险分析 150
- 四、政策和体制风险 151
- 五、外资进入现状及对未来市场的威胁 152

第四节 博思数据专家建议 152

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，进出口数据主要来自海关及商务部，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1409/T12853SYP0.html>